

Title (en)  
Flooring material.

Title (de)  
Bodenbelag.

Title (fr)  
Revêtement de sol.

Publication  
**EP 0269871 A2 19880608 (DE)**

Application  
**EP 87115944 A 19871030**

Priority  
• DE 3640739 A 19861128  
• DE 3712881 A 19870415  
• DE 3719443 A 19870611

Abstract (en)  
The floor covering according to the invention is intended for industrial warehouses, especially large-area storage depots, and is intended, on the one hand, to be capable of supporting high loads from vehicles, machines and stock and, on the other hand, to guarantee reliable protection against the undesirable escape of environmentally harmful fluids into the ground (5). It consists of a plurality of covering elements (11) which can be welded together and which have an upper board (1), a lower board (2) and a gap (8) arranged between these two boards and of a width defined by a layer of expanded metal (3). The gaps (8) can be evacuated and are connected via a measuring line (16) to a leakage monitoring unit (17). <IMAGE>

Abstract (de)  
Der erfindungsgemäße Bodenbelag ist für Industriehallen, insbesondere großflächige Lagerhallen, bestimmt und soll einerseits durch Fahrzeuge, Maschinen und Lagerware hoch belastbar sein, und andererseits einen sicheren Schutz gegen ungewolltes Austreten von umweltgefährdenden Flüssigkeiten in den Untergrund (5) gewährleisten. Er besteht aus mehreren miteinander verschweißbaren Belagelementen (11), die eine Oberplatte (1), eine Unterplatte (2) und einen zwischen diesen beiden Platten angeordneten, in seiner Weite durch eine Streckmetallschicht (3) bestimmten Spaltraum (8) aufweisen. Die Spalträume (8) sind evakuierbar und sind über eine Meßleitung (16) an ein Lecküberwachungsgerät (17) angeschlossen.

IPC 1-7  
**E04B 1/92**; **E04F 15/02**

IPC 8 full level  
**E04B 1/92** (2006.01); **E04F 15/02** (2006.01)

CPC (source: EP US)  
**E04F 15/02** (2013.01 - EP US)

Cited by  
US5335536A; DE4236219A1; WO9200431A1

Designated contracting state (EPC)  
AT BE CH DE ES FR GB IT LI

DOCDB simple family (publication)  
**EP 0269871 A2 19880608**; **EP 0269871 A3 19891206**; **EP 0269871 B1 19910206**; AT E60817 T1 19910215; DE 3767985 D1 19910314; US 4916939 A 19900417

DOCDB simple family (application)  
**EP 87115944 A 19871030**; AT 87115944 T 19871030; DE 3767985 T 19871030; US 12481787 A 19871124